

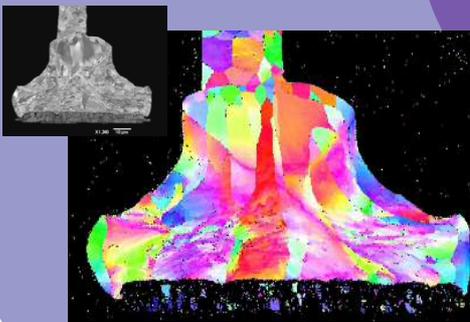
メルコセミコンダクタエンジニアリング株式会社

受託分析評価サービスのご案内

エレクトロニクス分野で培った高度な分析技術と先端の装置で
さまざまな分野での開発・トラブル解決をサポートします!

PKG組立・実装関連

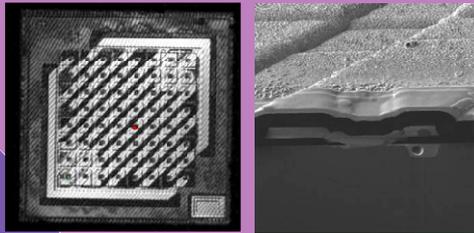
- ILB・WB接合解析
- はんだ材接合解析
- めっき皮膜構造解析
- 樹脂・基板材料分析



Auワイヤー断面の結晶方位解析(EBSP)

パワーデバイス関連

- 故障位置特定解析
- 故障部位物理解析
- キャリア濃度測定
- 拡散濃度プロファイル



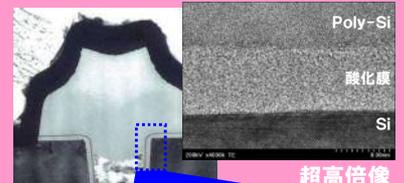
故障位置の発光像
(裏面OBIRCH)

故障位置の
断面像(FIB)

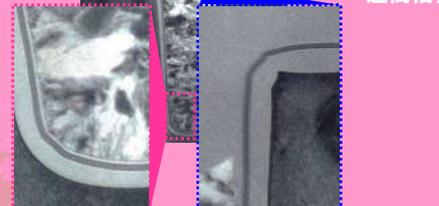
デバイスの故障解析(OBIRCH・FIB)

Wafer関連

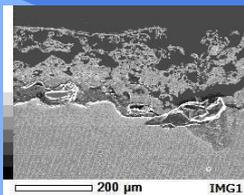
- デバイス構造解析
- メタルカバレッジ評価
- 装置内発塵分析
- 薬液不純物分析



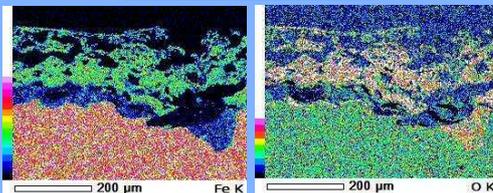
超高倍像



デバイスの構造解析(STEM・TEM)



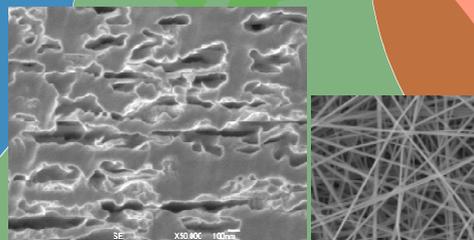
200 μm IMG1



炭素鋼腐食食品断面の元素分析(EDX)

金属材料

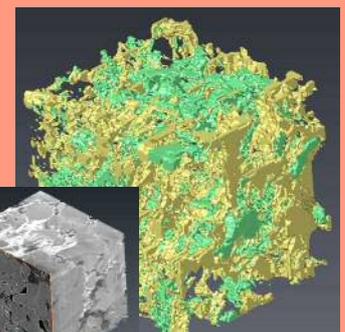
- 破面解析
- 腐食品・防食品分析
- 金属組織観察
- 機械試験・物性評価



有機材料の形態観察
(クライオ断面加工・低真空SEM)

高機能有機材料

- 形態観察・表面分析
- 高分子構造解析
- 機械試験・物性評価
- 微量成分分析



3D再構築像 導電助剤と空隙の空間分布
Li正極の3D構造解析(FIB-SEM)

太陽電池・Li二次電池

- 電池構造解析
- 各種大気非暴露分析
- リチウムイオン電池の
試作・環境試験